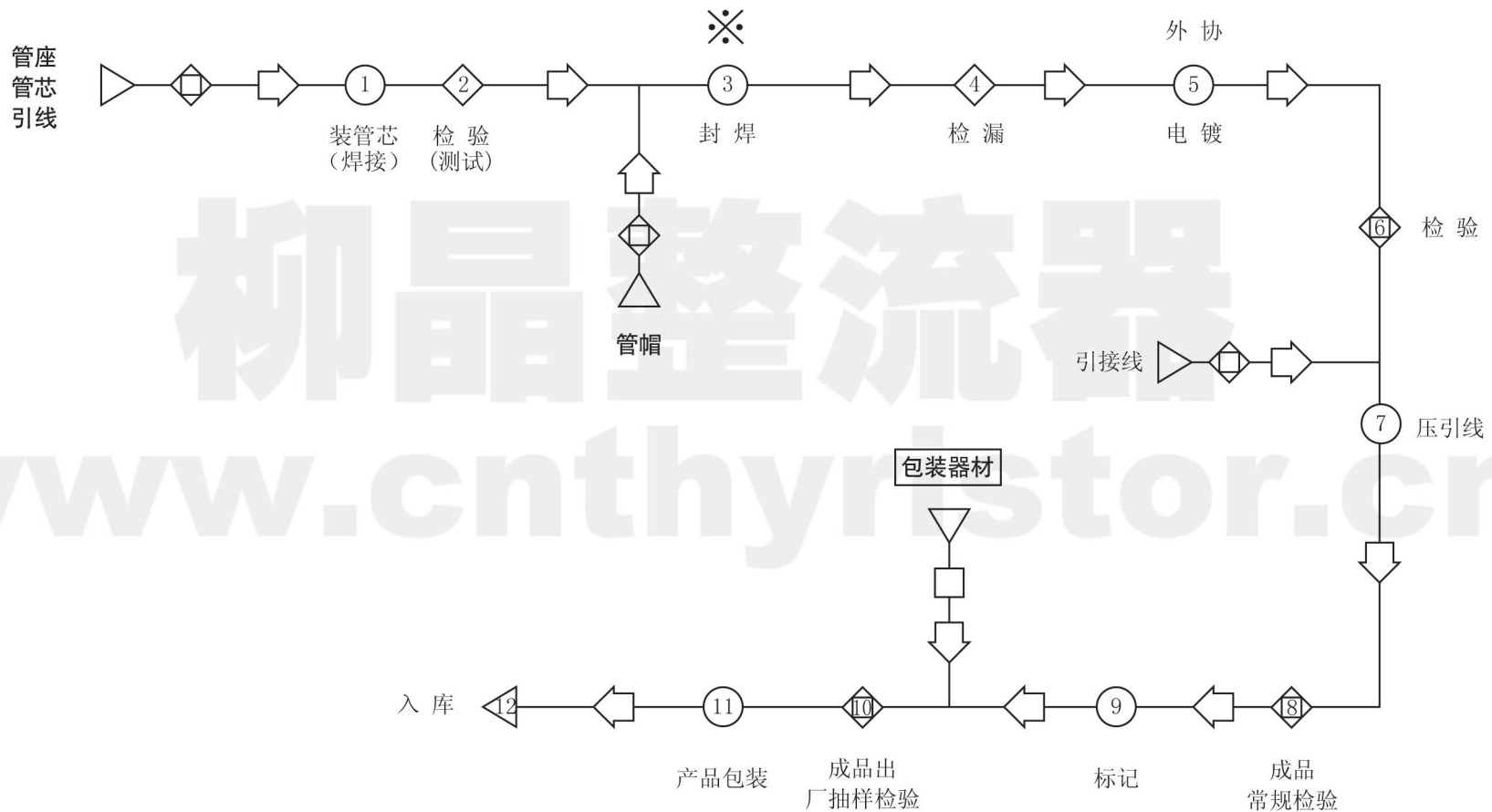


ZP200 整流管工艺流程图



注：“※”为关键工序（质控点：本工序如封焊工序参数不能达到要求会造成漏焊，使产品中混入空气会使芯片氧化特把此工序设置为质控点）

描 图
描 校
底 图 号
装 订 号

										设计(日期)	审核(日期)	标准化(日期)	会签(日期)	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期					